

令和 3年 5月 13日

NEDIA 会員各位

日本電子デバイス産業協会
材料部品部会 小林 関司

「第三十一回勉強会」のご案内

惜春の候 皆様にはご健勝のこととお喜び申し上げます。

さっそくですが、下記の日程で材料部品部会(旧 JAST 部会)主催の「第三十一回勉強会」を開催いたします。現在、米中貿易摩擦、さらに新型コロナウイルスの世界的な感染の影響で、世界経済が大混乱に陥っております。一方、世界的な半導体不足による電装品不足も起きているようです。

我々の業界にどのような影響が出てくるのか予断を許さない状況になっております。このような状況の中で我々としては、現状をどう認識し今後どのように対応すればよいのかを勉強したいと思います。

現在、緊急事態宣言が発令されておりますので消毒、換気等に十分気を付けながらの実施になります。都内の感染者数の激増等最悪の状態になりました時は、延期になることもありますのでご承知おきください。

今回の勉強会では、車載用半導体の動向および半導体全般の最新市況と今後の対応についてお二人の先生にお話をさせていただきますのでご参加をお待ちしております。

— 記 —

日時 令和 3年6月10日(木曜日) 14:00-16:30

場所 御茶ノ水めっきセンター(4F) 03-3814-5621 (代)

東京都文京区湯島1-11-10

[スケジュール]

(1) 14:00~14:50 (50分)

講師 大山 聡 氏/グロスバーグ合同会社 代表

テーマ 「車載半導体市場の動向」

休憩 14:50~15:00

(2) 15:00~16:30 (90分)

講師 泉谷 渉 氏/(株)産業タイムズ社 代表取締役社長

テーマ 「風雲急を告げる半導体の未来像」

~~装置/材料産業は、万歳三唱の時だ!!~~

(注1) 今回参加される方には、資料代として2,000円/人徴収いたします。(非会員の方には、資料代込みで5,000円)

(注2) 添付いたします出欠用紙での回答を、6月7日までにメールでお願いいたします。なお新型コロナウイルス感染防止の関係で定員(40名)になり次第参加申し込みを締め切らせていただきます。

以上